

TAZMO

タツモ株式会社 決算説明資料

2023年12月期

2024年2月19日

証券コード 6266

会社案内ダウンロード



2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様やそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

この地震による当社グループへの影響について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 被害の状況について

当社グループにおける人的被害および物的被害はありません。

2. サプライヤーからの部品調達状況について

当社グループの部品調達先におきましては、被災しているサプライヤーは一部あるものの、現時点（2024年2月19日現在、以下同じ）で当社グループの部品調達や生産スケジュールに重大な影響を与えるような事象は発生しておりません。

3. 業績に与える影響

この地震による当社グループへの業績への影響につきましては、現時点で確認されている事項はありません。今後開示すべき重大な事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以上

INDEX

目次



01

2023年12月期 決算報告

02

2023年12月期 セグメント別業績

03

2024年12月期 業績予想

04

補足資料

A blue rectangular box with rounded corners containing a white globe graphic with latitude and longitude lines. The number '01' is overlaid on the globe in a large, white, sans-serif font.

01

2023年12月期 決算報告

売上は年初計画を下回ったものの、前年比では増収増益を達成

売上高

28,161百万円

前期比 +15.6%

営業利益

3,654百万円

前期比 +30.2%

経常利益

3,890百万円

前期比 +23.9%

親会社株主に帰属
する当期純利益

2,356百万円

前期比 +4.1%

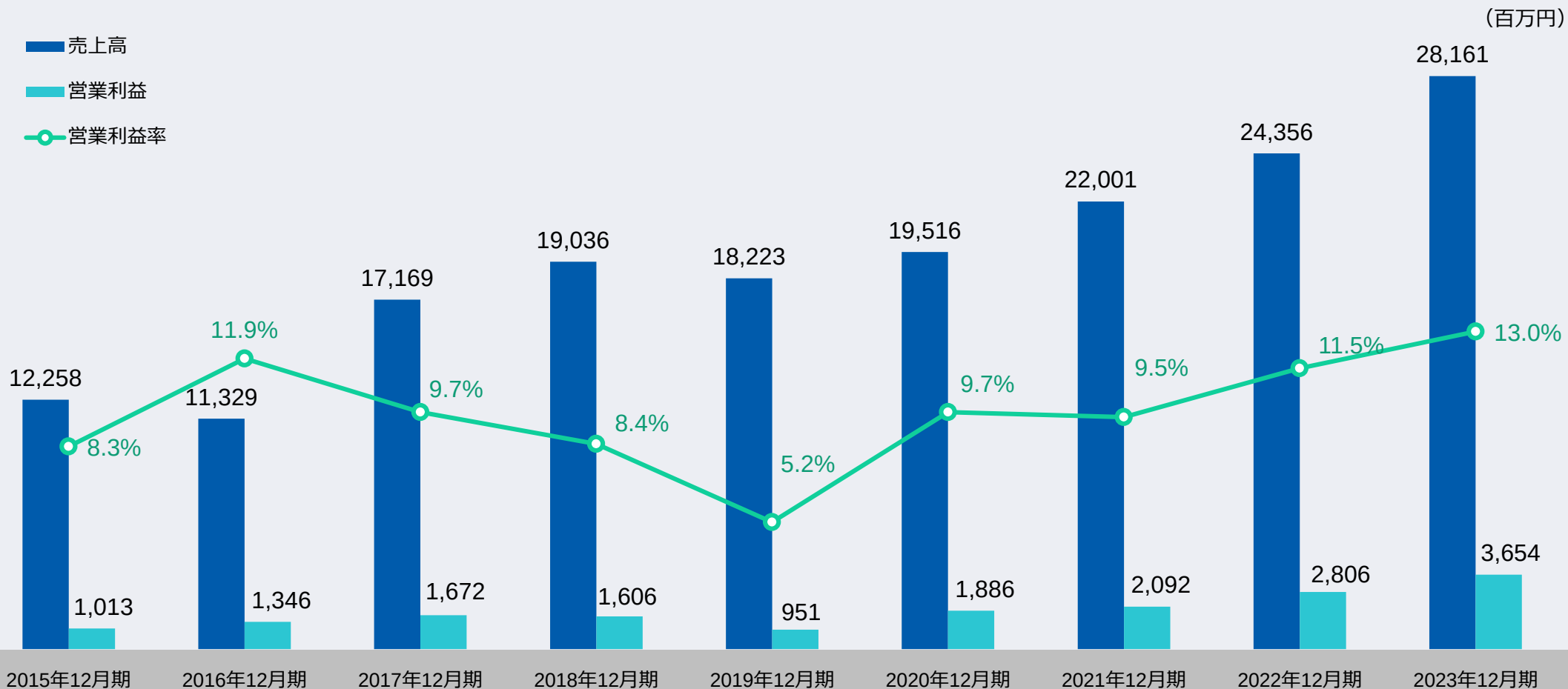
■ 概況

- 2023年12月期においては、パワー半導体向け装置が売上・利益の増加に寄与
- 一部で検収や設備投資の遅れが発生
- 円安の進行により、営業外収益で為替差益2億29百万円を計上
- 投資有価証券減損処理のため、3億35百万円を計上

検収遅延などがあったものの、主にパワー半導体向け装置の需要が堅調で利益をけん引

(百万円)	2022年12月期 実績	2023年12月期		前期比 増減率(%)	2023年12月期 計画	計画比(%)
		実績	売上比(%)			
売上高	24,356	28,161	—	15.6	31,423	△10.4
売上総利益	7,328	8,558	30.4	16.8	—	—
営業利益	2,806	3,654	13.0	30.2	3,118	17.2
経常利益	3,138	3,890	13.8	23.9	3,087	26.0
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,263	2,356	8.4	4.1	2,109	11.7
自己資本利益率 (ROE)	14.8%	12.7%	—	△2.1P	—	—

売上は当初計画未達だったものの、売上・利益ともに過去最高を更新



資産では仕掛品の増加、負債では長期借入の増加が主な増減要因となった

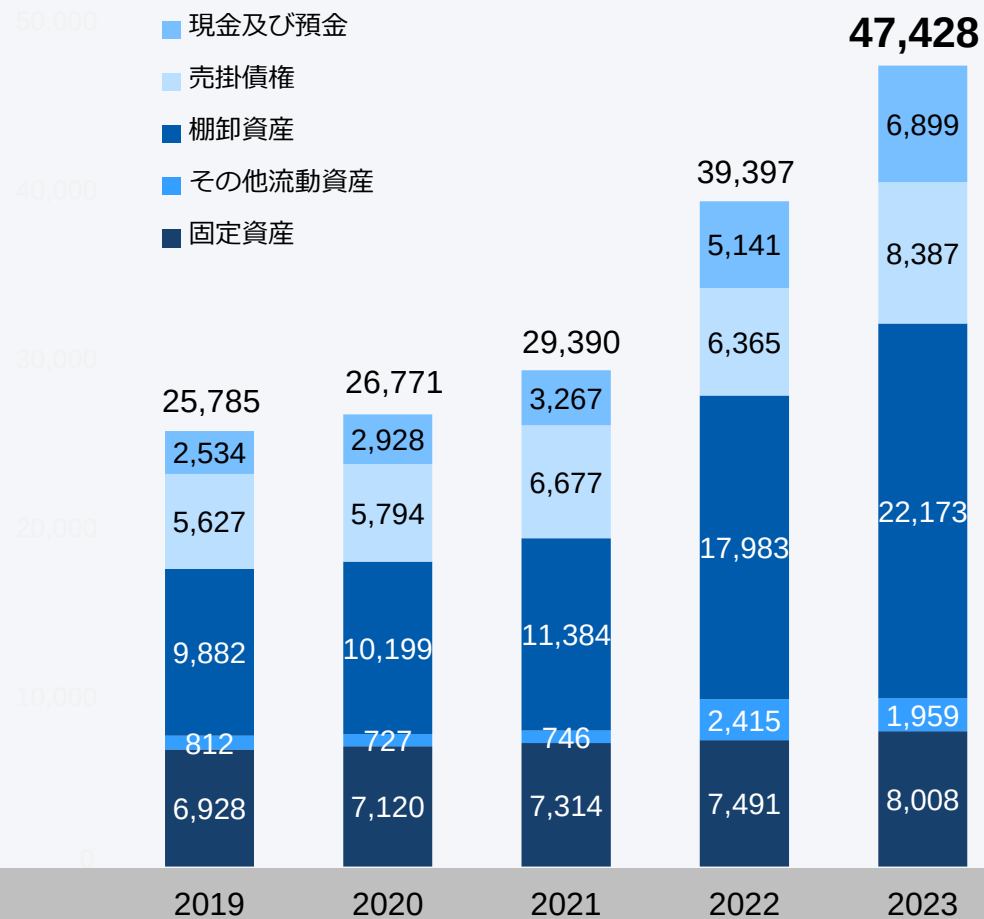
(百万円)	2022年12月期	2023年12月期	前期比 増減率(%)
流動資産	31,905	39,420	23.6
固定資産	7,491	8,008	6.9
有形固定資産	6,267	7,007	11.8
無形固定資産	198	157	△20.4
投資その他資産	1,025	842	△17.8
総資産合計	39,397	47,428	20.4
流動負債	18,463	21,380	15.8
固定負債	3,384	5,952	75.9
負債合計	21,847	27,333	25.1
純資産合計	17,549	20,095	14.5
自己資本比率	43.9%	41.7%	△2.2P

主な増減要因

流動資産	(百万円)
現金及び預金	+ 1,758
受取手形及び売掛金	+ 1,178
仕掛品	+ 3,979
流動負債	
短期借入金	+ 1,157
契約負債	+ 1,554
固定負債	
長期借入金	+ 2,432

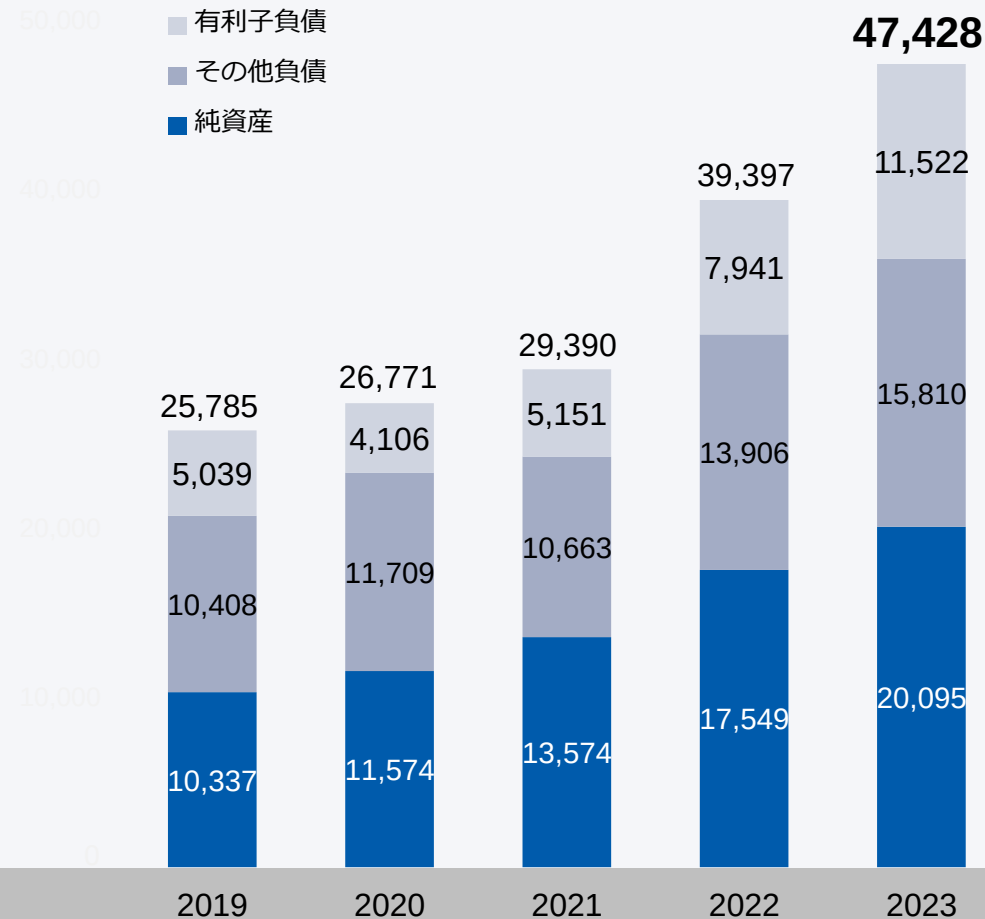
売上高資産

(百万円)



負債／純資産

(百万円)



棚卸資産の増加額は前期比で減少したものの、営業CFでの主な資金の減少要因となった

(百万円)	2022年12月期	2023年12月期	前期比 増減率(%)
営業活動による キャッシュ・フロー	△1,513	△261	△82.7
投資活動による キャッシュ・フロー	△669	△1,392	107.9
フリー・キャッシュ・ フロー	△2,183	△1,653	△24.3
財務活動による キャッシュ・フロー	4,098	3,275	△20.0
現金及び現金同等物の 期末残高	5,024	6,771	34.8

主な内訳

営業CF	(百万円)
税金等調整前当期純利益	3,549
棚卸資産の増加額	△4,023
契約負債の増加額	1,506
投資CF	
有形固定資産の取得による支出	△1,355
無形固定資産の取得による支出	△41
財務CF	
長期借入	5,200
長期借入金の返済	△2,110



02

2023年12月期 セグメント別業績

		2022年12月期 実績	2023年12月期 実績	前期比 増減率(%)	2023年12月期 計画	計画比(%)	
(百万円)							
プロセス機器事業	売上高	19,192	22,437	16.9	22,974	△2.3	
	営業利益	2,635	3,715	41.0	2,731	36.0	
	■ 半導体装置	売上高	5,997	6,773	12.9	8,222	△17.6
	■ 搬送機器	売上高	7,136	7,936	11.2	7,453	6.5
	■ 洗浄機	売上高	2,864	4,954	72.9	4,412	12.3
	■ コーター	売上高	3,193	2,774	△13.1	2,885	3.9
金型・樹脂成形事業	売上高	1,400	1,456	4.0	2,156	△32.4	
	営業利益	11	△29	－	56	－	
表面処理用機器事業	売上高	3,763	4,267	13.4	6,292	△32.2	
	営業利益	175	△22	－	330	－	
セグメント間連結消去		営業利益	△16	△8	－	－	
合計	売上高	24,356	28,161	15.6	31,423	△10.4	
	営業利益	2,806	3,654	30.2	3,118	17.2	

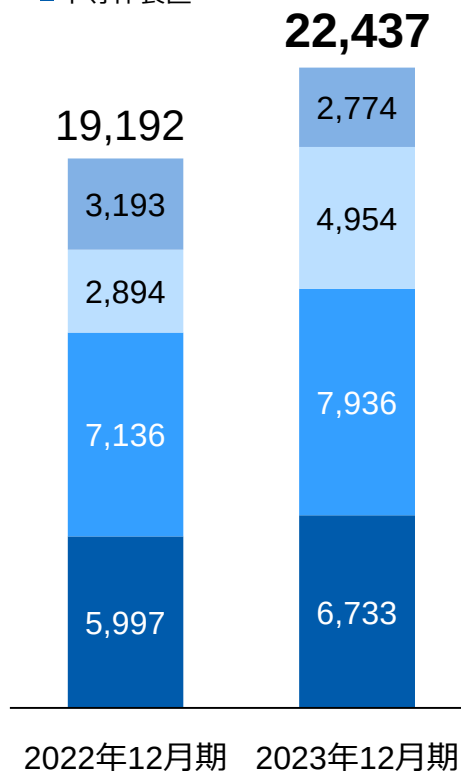
売上高

■コーター (百万円)

■洗浄機

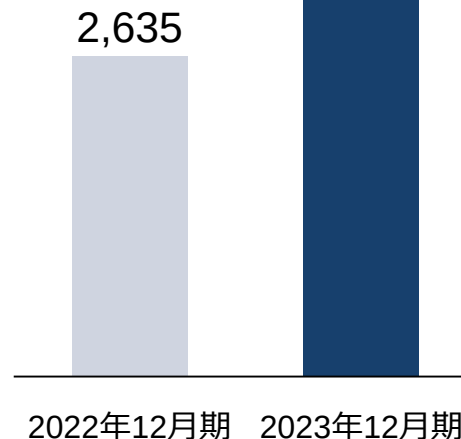
■搬送機器

■半導体装置



営業利益

(百万円)



概況

- 半導体装置：パワー半導体向け装置が売上・利益に貢献
- 搬送機器：生産効率の改善効果があり増収
- 洗浄機：概ね計画通りに検収が進み増収
- コーター：フラットパネルディスプレイ関連メーカーの設備投資が鈍化

市場の状況

プロセス機器事業全体

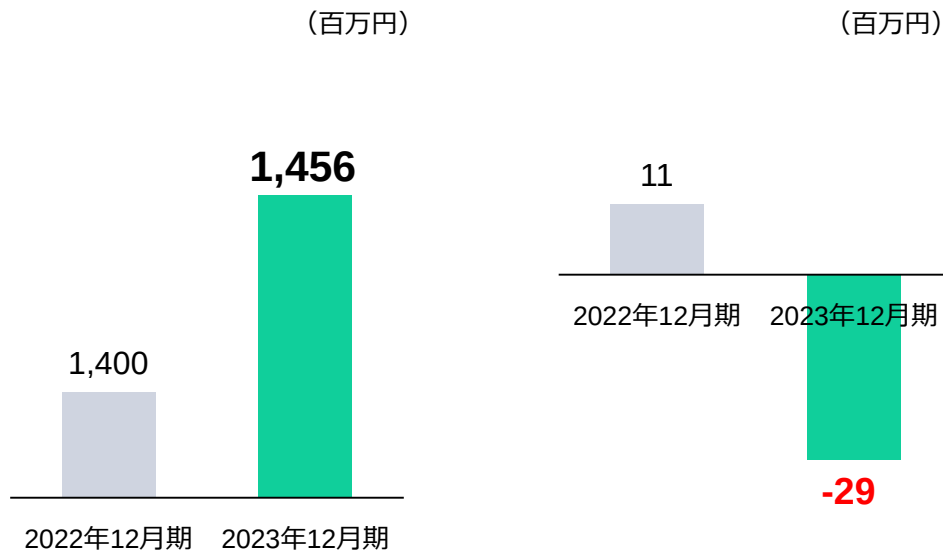
半導体製造装置市場は設備投資の鈍化から回復途上。当社においてはパワー半導体向け装置の需要が堅調であり、売上・利益に寄与した。また、アドバンスドパッケージ向け装置の需要も今後拡大すると見込まれる。

一部では検収の遅れが発生するも、2023年12月期の利益は当初計画を上回る結果となった。

金型・樹脂成型品事業

売上高

営業利益



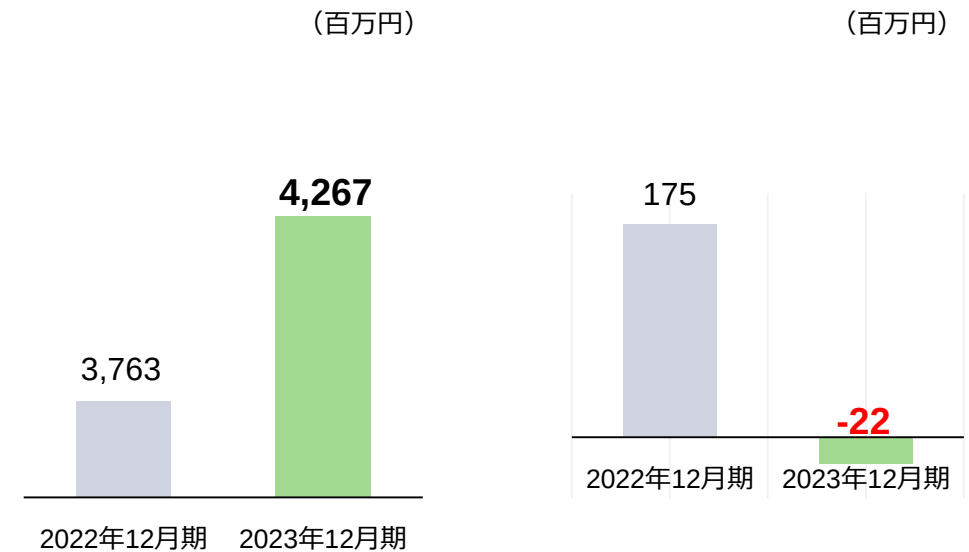
コネクタメーカーの在庫調整が長引き、電子部品の需要が減少。

円安の進行、原材料やエネルギーの高騰も利益を圧迫している要因となっている。

表面処理用機器事業

売上高

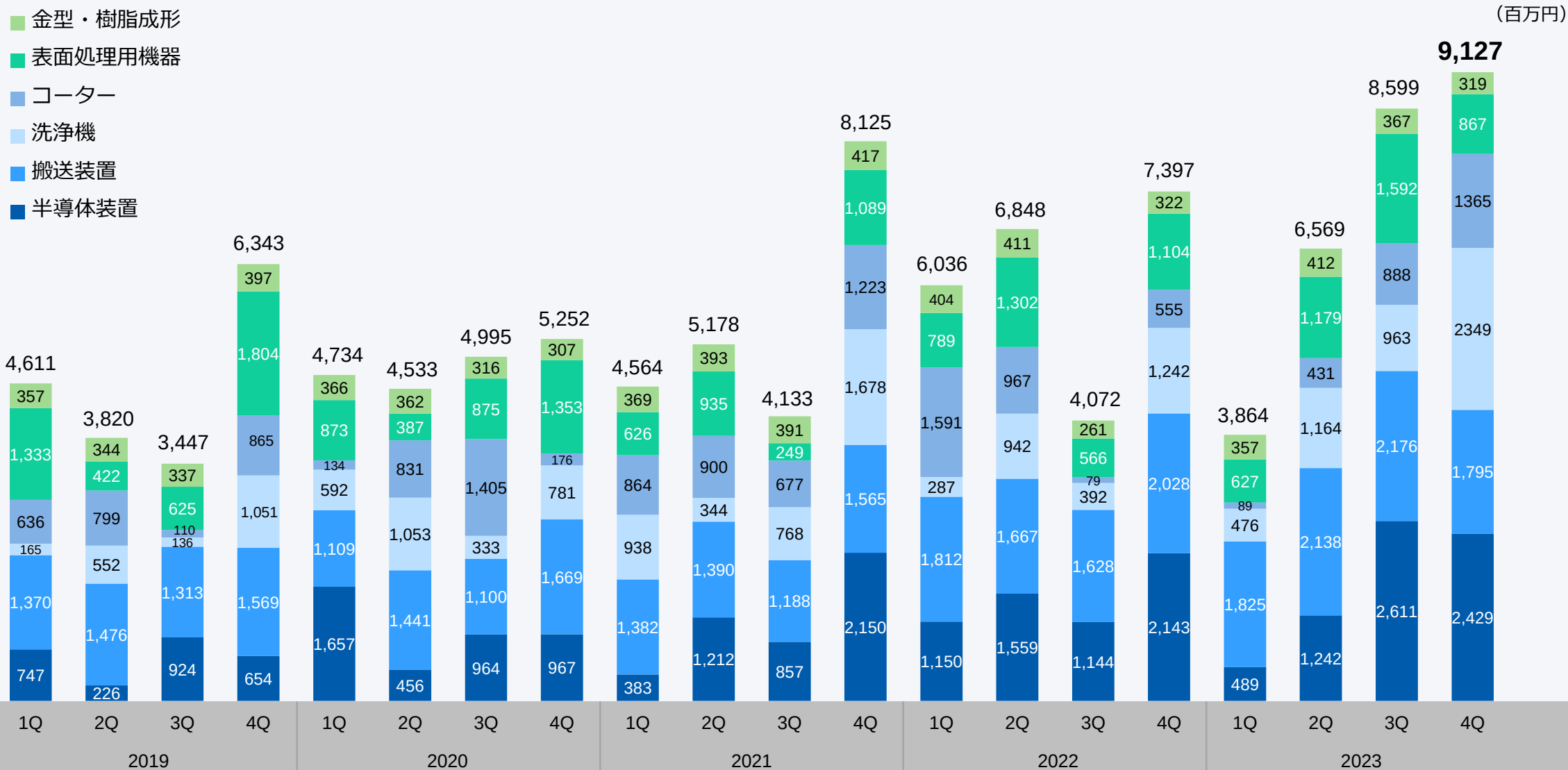
営業利益



一部メーカーの設備投資が遅れている影響はあるものの、売上高は過去最高を更新。

売上高は過去最高であったが、利益率の低い装置の売上や、納入後の製品補償費が増加したことが営業損失につながった。

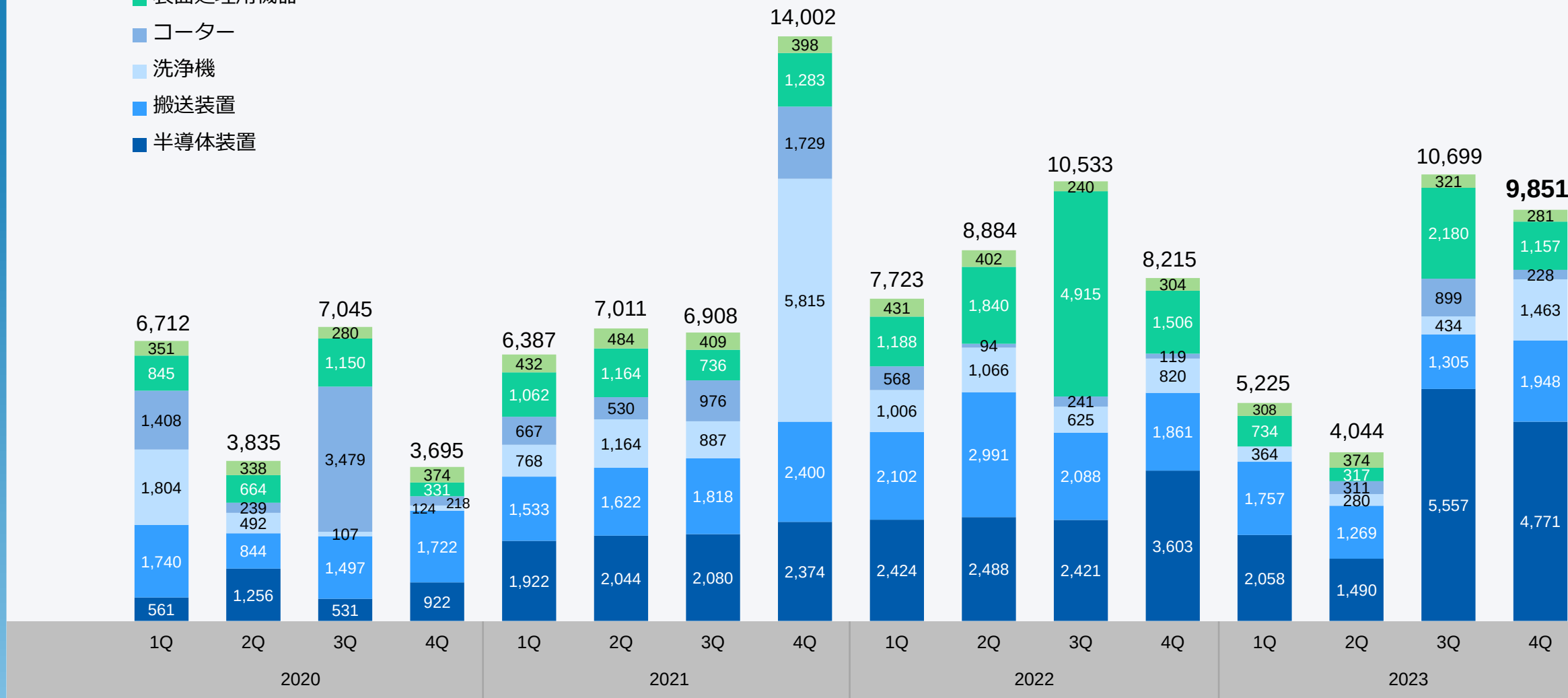
セグメント別 売上高推移



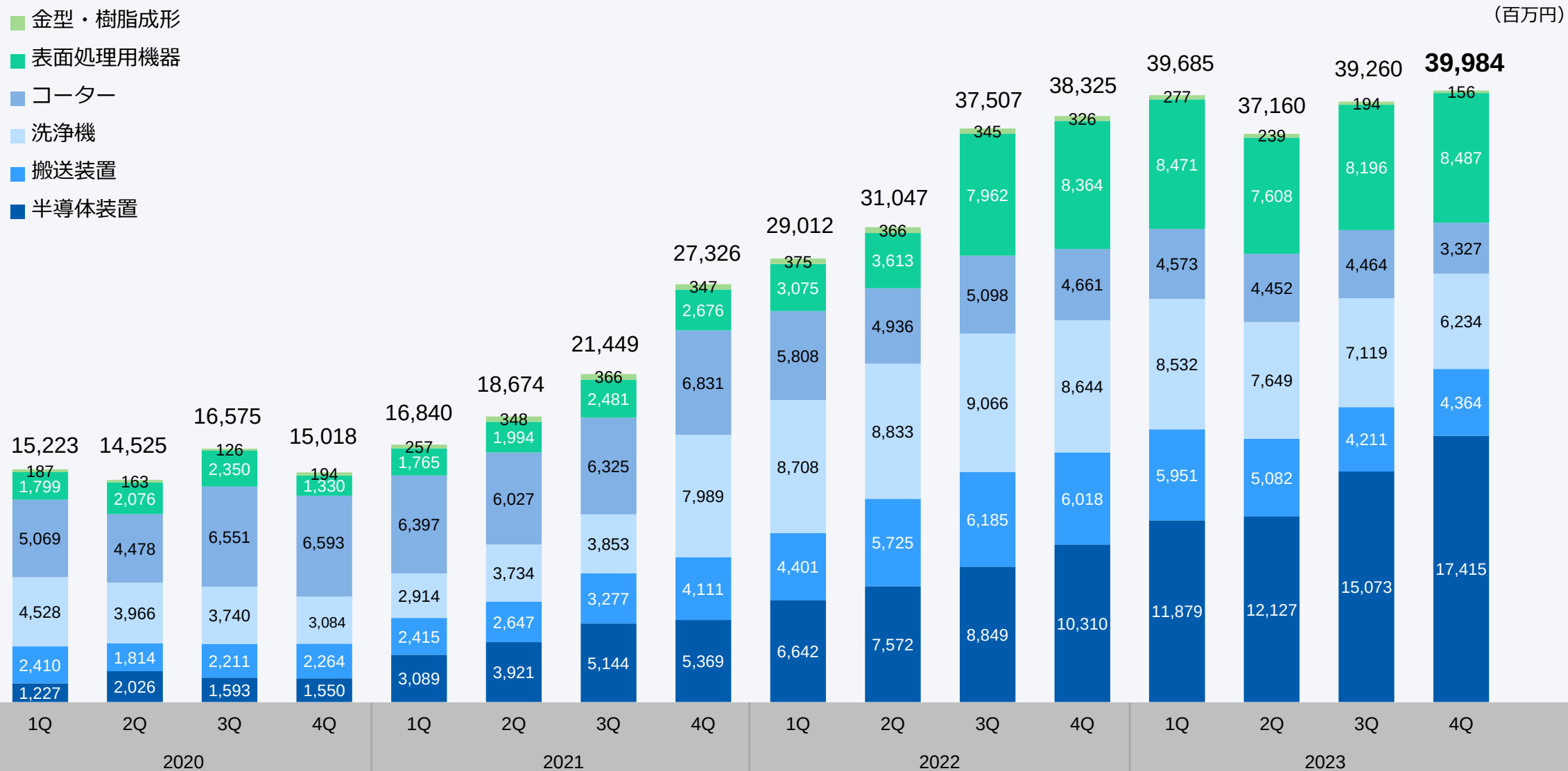
セグメント別 受注高推移

(百万円)

- 金型・樹脂成形
- 表面処理用機器
- コーター
- 洗浄機
- 搬送装置
- 半導体装置



セグメント別 受注残高推移





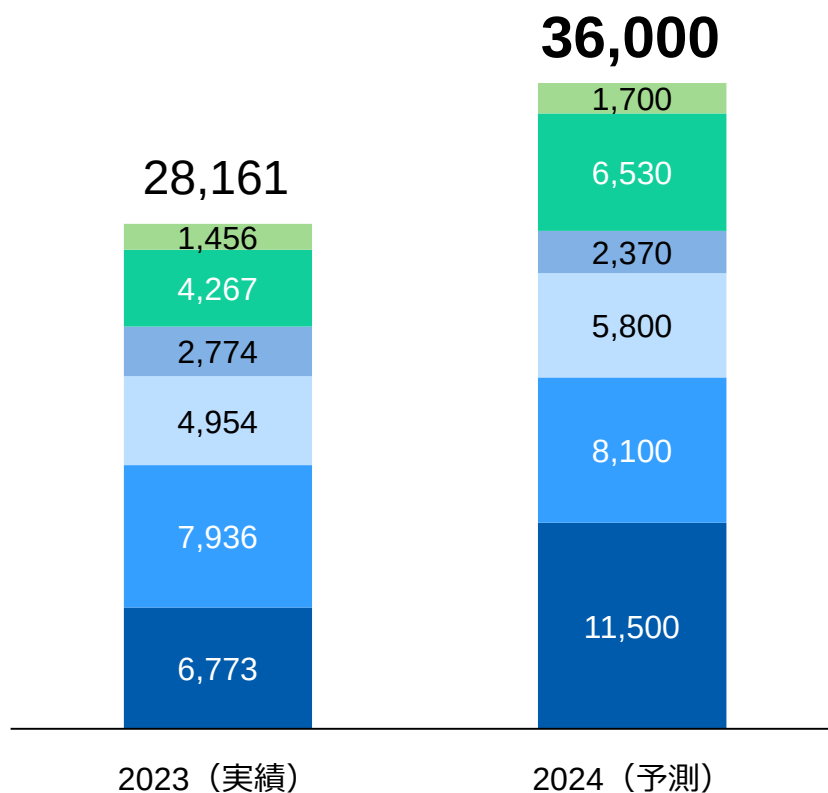
03

2024年12月期 業績予想

(百万円)	第2四半期累計	通期	前期比 増減率 (%)
売上高	16,865	36,000	27.8
プロセス機器事業	14,707	27,770	23.8
金型・樹脂成形事業	842	1,700	16.8
表面処理機器事業	1,316	6,530	53.0
営業利益	2,110	4,600	25.9
プロセス機器事業	2,147	4,250	14.4
金型・樹脂成形事業	22	30	—
表面処理機器事業	△60	320	—
経常利益	2,090	4,500	15.7
親会社株主に帰属する当期純利益	1,455	3,060	29.9

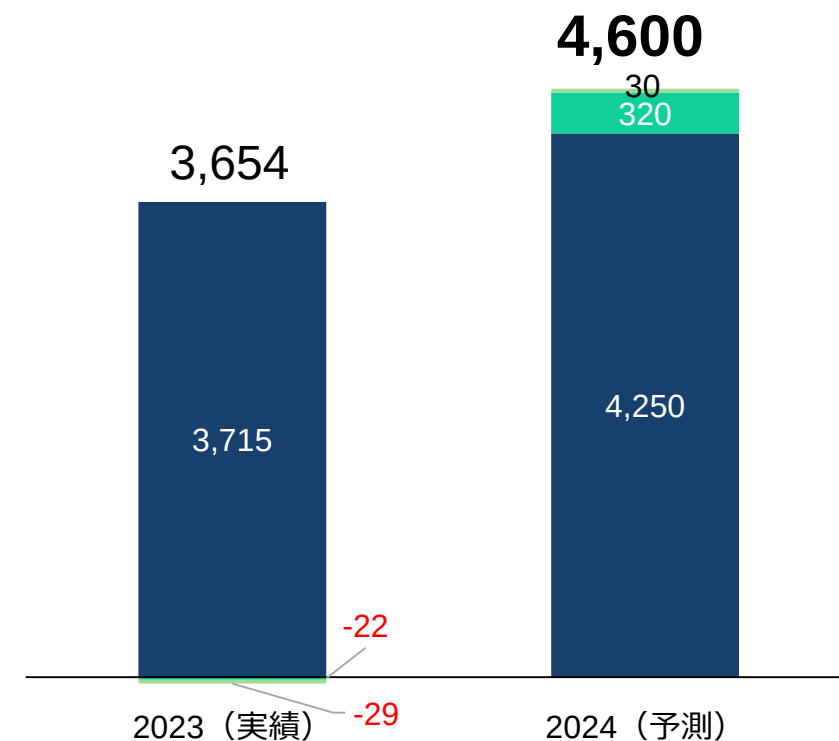
売上高

■ 金型・樹脂成形 ■ 表面処理用機器 (百万円)
■ コーター ■ 洗浄機
■ 搬送機器 ■ 半導体装置

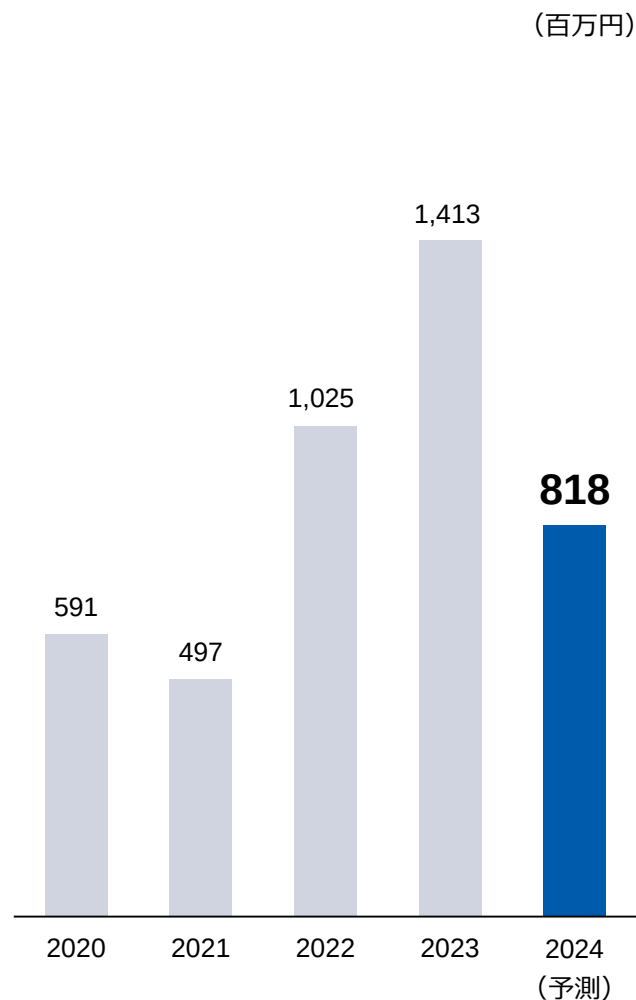


営業利益

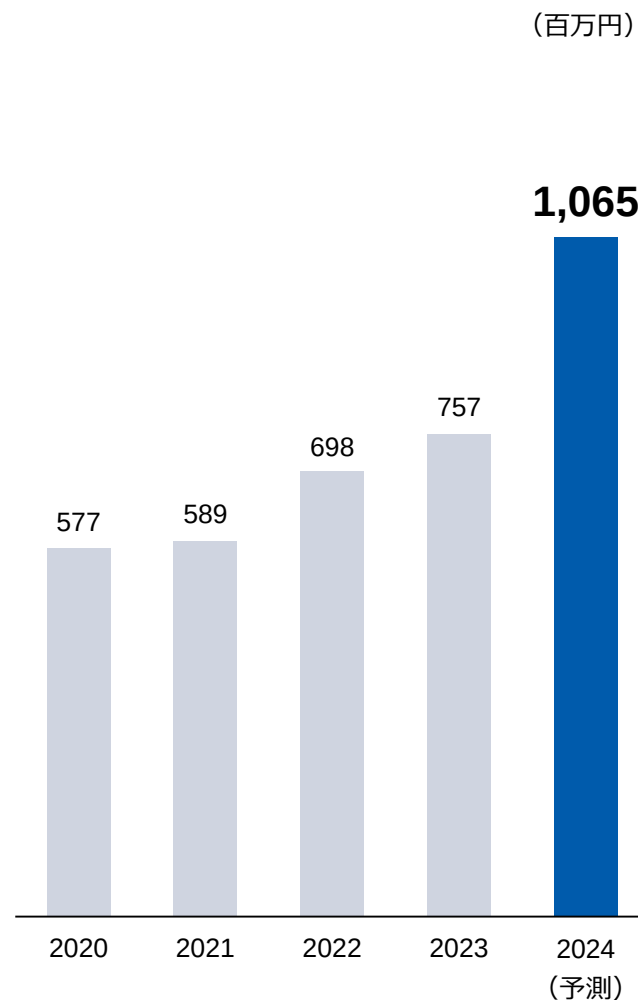
■ 金型・樹脂成形 (百万円)
■ 表面処理用機器
■ プロセス機器



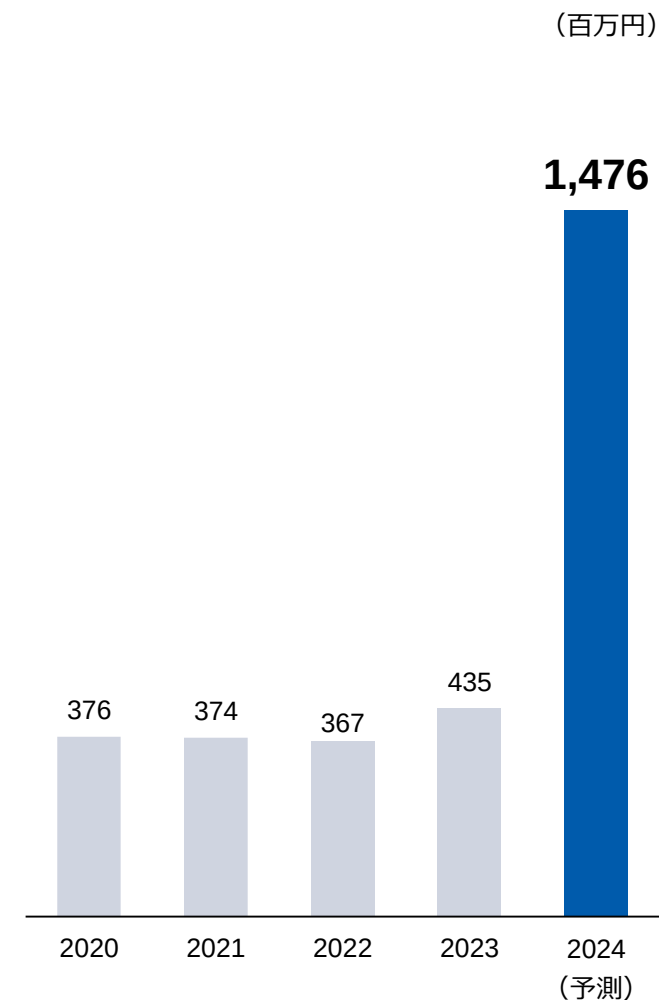
■ 設備投資



■ 減価償却費

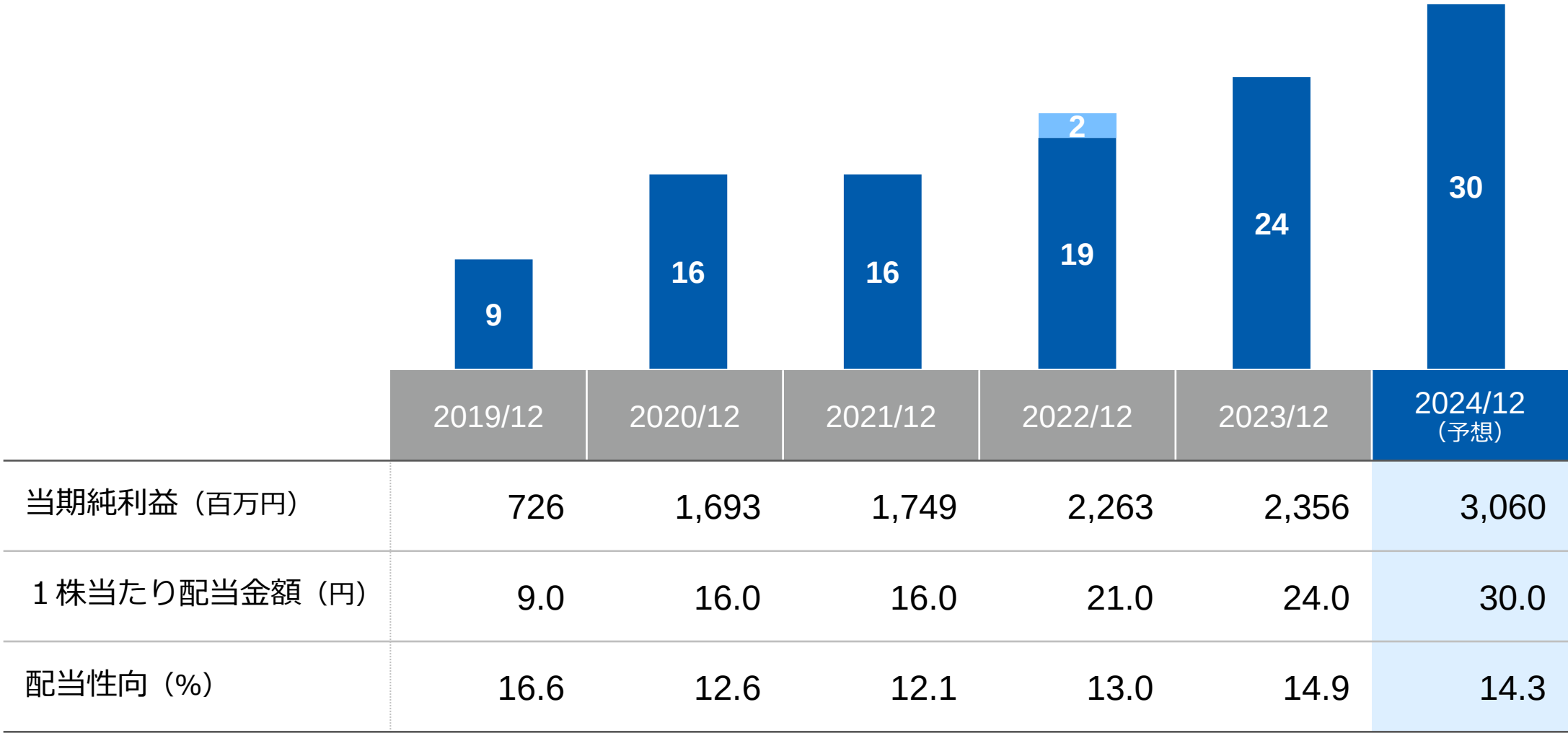


■ 研究開発費



- 半導体製造装置は、国内・欧州でのパワー半導体向け装置の受注・引合い有り。Siは軟調だがSiC向けでの引合いは堅調。また、アドバンスドパッケージについてはまとまった受注もあり、今後の市場の拡大に強く期待している。
- 搬送機器ではメモリー／ロジックの市場状況の影響がまだ残っている、状況回復にはもう少し時間がかかりそう。
- 洗浄装置では、大きな案件ではないが少しずつ新規案件の話が出てきている。スラリー供給装置の受注・引合いが増加してきている。
- 表面処理用機器は国内外共に引合いは多く、生産計画を調整し受注に結びつけている。製造キャパの増強を検討中。遅延していた基板搬送関連も今期納入が進む予定。
- 部品調達については、今後の市場回復に向けて在庫と新たな調達先の管理と確保等、リードタイムの短縮に対する対策を検討中。
- 中国 紹興市の子会社建物が完成。デモ設備を導入し、中国内でのデモ及び客先との評価を進める。

■ 普通配当 ■ 50周年記念配当



A blue rectangular box with rounded corners containing a white globe graphic with latitude and longitude lines. The number 04 is overlaid on the globe.

04

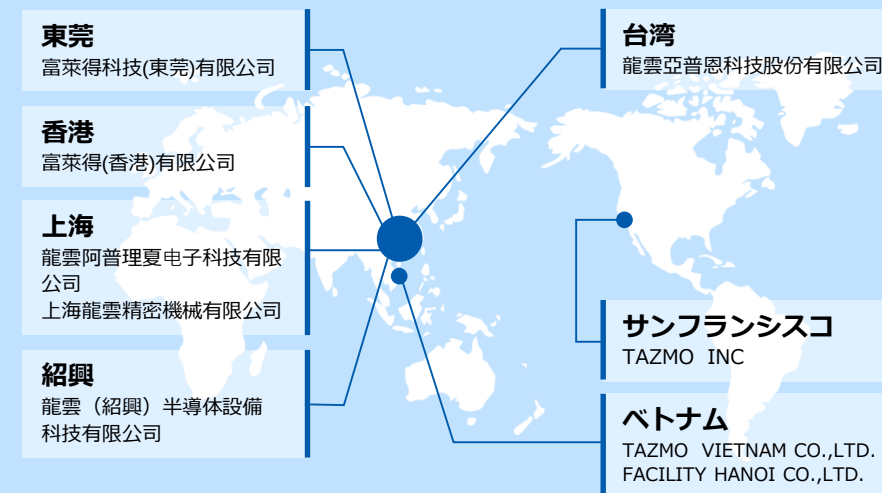
補足資料

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億5,689万6,587円
発行済株式数	14,836,691株
株主数	4,961名（2023年12月31日現在）
従業員数	単体 382名／連結 1,141名（2023年12月31日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 液晶製造装置、紫外線照射装置、めっき処理装置、 精密金型・樹脂成型品などの開発・製造・販売

国内拠点・関連子会社



海外拠点



- | | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|
| 1972 | ● | - 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立 | 2009 | ● | - 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結 |
| 1980 | ● | - インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始 | 2013 | ● | - アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築 |
| 1989 | ● | - 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始 | 2017 | ● | - 株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化 |
| 1990 | ● | - 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始 | 2018 | ● | - 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
| 1994 | ● | - エンボスキャリアテープの製造・販売を開始 | 2019 | ● | - 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転 |
| 1995 | ● | - インジェクション成形品の製造・販売を開始 | 2020 | ● | - アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併 |
| 2001 | ● | - 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始 | 2022 | ● | - 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立 |
| 2004 | ● | - JASDAQ市場に株式を上場 | | | |
| 2008 | ● | - TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立 | | | |

最先端の半導体やパッケージを製造する装置をはじめ、有機ELや液晶ディスプレイなどの製造装置、クリーン搬送ロボットなどを開発・製造・販売する事業を展開

半導体製造装置事業

半導体製造における塗布・現像・貼合・剥離など、各種プロセスに対応した装置を、40年に渡って培ったノウハウ・技術により、全世界に提供



搬送機器事業

半導体製造に欠かせないシリコンウェーハ等の搬送ロボットをはじめ、正確性・スピーディーさ・省スペースに対応した各種搬送システムを提供



洗浄装置事業

半導体製造の重要な工程であるシリコンウェーハ洗浄・スラリー供給装置や、廃液からリン酸を再生・再利用する装置を提供



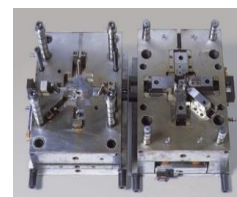
コーター事業

液晶ディスプレイ等、各種フラットパネル製造装置を提供。現在はPLP用装置やナノインプリント装置の開発を進めている。



金型・樹脂成形品事業

部品製造に欠かせない金型技術は、創業時からのコア技術であり、ユーザー企業の様々なニーズに応える形で各種製品を提供



表面処理用機器事業

半導体のパッケージや、自動車等の電子制御システムに組み込まれている、プリント回路基板に対するめっき処理装置の提供



当社では、TCFD提言に基づく各種情報開示を行っています。

ガバナンス・リスク管理



- **サステナビリティ委員会を設置**
 - ・ 年2回（4月・10月）の開催
 - ・ 取締役会と連携しながら、推進施策の決定や全社の取り組みを監視
 - ・ 特に環境に対する取り組みは当委員会で方針を決定・各所に共有・報告を実施
- **報告を踏まえ、担当部署にリスク対策を含む事業戦略・中期計画の作成を指示**

戦略



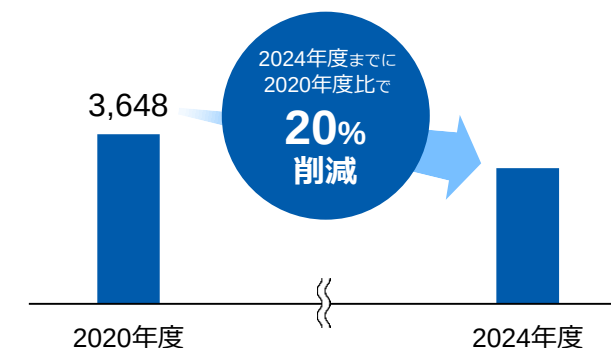
- 将来の気候変動に対するリスクや機会を分析し、財務への影響について特定
- その対策として、下記を順次検討・実施
 - ・ **自家消費型太陽光発電設備の設置（2023年9月施工完了）**
 - ・ **全社照明設備のLED化の推進（2023年3月施工完了）**
 - ・ **再生可能エネルギー由来の電力などへ切り替え**
 - ・ **設備更新などによる電力効率化への取り組み**

指標と目標



- 事業活動を通じたカーボンニュートラルの実現を目指すため、自社のCO2排出量を継続的に把握、削減目標達成のための施策を実行
- CO2排出量については、現状は自社単体での開示を行い、順次グループ全体の排出量把握・削減への取り組み実行を予定

CO2排出量削減目標（2022年～2024年）



本資料の取扱上の注意

本資料は、2024年2月13日発表の決算短信に基づいて作成されております。

また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、当社の発行する有価証券売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室



086-239-5000



086-239-5100



keiki@tazmo.co.jp